

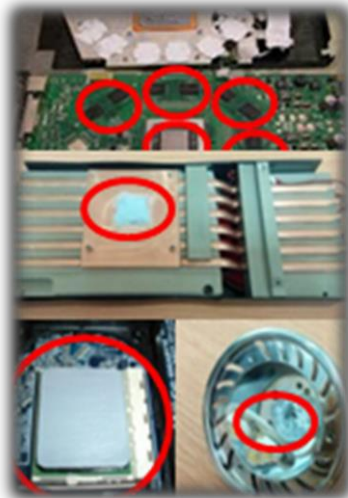
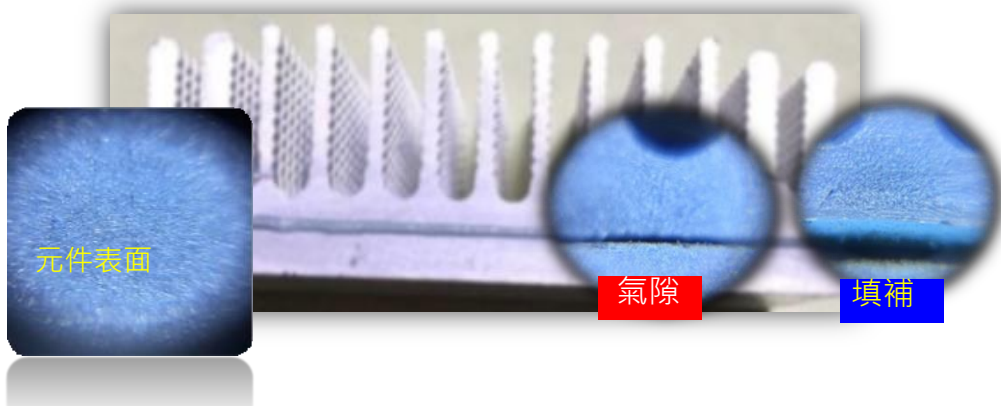
HIGH PERFORMANCE THERMAL GEL MATERIAL TR Series

描述

熱凝膠 (TR 系列) 是 DS 公司為滿足當前和未來高性能微處理器的熱管理要求而開發的熱介面材料。它用於通過關閉處理器頂部和散熱器之間存在的氣隙來提高散熱器的有效性。在處理器進入插槽後,凝膠應用於處理器頂部的凸起區域。在薄和厚間隙提供較低的熱阻,允許使用普通散熱器,在極端溫度迴圈和衝擊振動中久經考驗的可靠性

典型運用

- Easily dispensable
- 具有粘性表面和可重操作的
高體積導熱係數
- 超低壓縮力 & 熱阻
- 久經考驗的長期可靠性



微處理器 圖形處理器記憶體
電源模組 電源半導體
消費電子汽車電子控制單元(ECU)平
板顯示器

熱凝膠 - TR Series

性質	TR3	TR4	單位	檢驗方式
顏色外觀	粉紅	綠	-	Visual
流量	20	19	grams/min	30cc syringe with no tip attachment 0.100" orifice, 90psi
比重(25°C) 典型的最小粘合層厚度	3.2 0.1	3.3 0.1	g/cc mm	ASTM D792 -
排氣 (150°C/24hr)	0.02	0.02	%TML(CVCM)	ASTM E595
油釋放(150°C/24hr)	0.05	0.03	%	-
導熱	3.1	4	W/m*k	ASTM D5470
熱容量	1	1	J/g-K	ASTM E1269
CTE	150	150	ppm/K	ASTM E831
體積電阻率	10 ¹⁴	10 ¹⁴	ohm-cm	ASTM D257
介電強度	6	6	(KVac/mm)	ASTM D149
介電常數	7	7	@100 kHz	ASTM D150
耗散係數	0.002	0.002	@100 kHz	-
RoHS 標準	YES		-	SGS
連續使用溫度	-40~180		°C	-

生產流程

